

KNITE2 プロセス

Electroless Ultra Thin Ni/Pd/Au Plating Processes

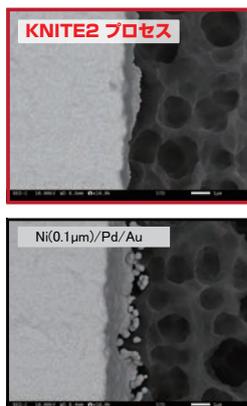
特長

- 微細Cu配線上へ選択析出性に優れためっき皮膜形成が可能です。
- めっき工程における下地金属のボイド発生を抑制し、安定した実装特性が得られます。
- 結晶サイズが均一なため、耐熱性に優れます。

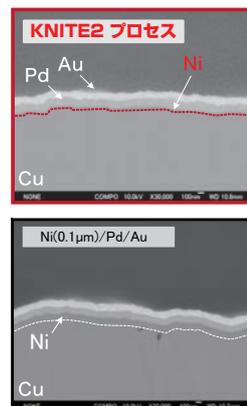
めっき工程

めっき工程	KNITE2 プロセス	Ni/Pd/Au
脱脂処理	○	○
エッチング処理	○	○
スマット除去処理	○	○
Pd触媒付与処理	—	○
無電解Niめっき	○ (0.01μm)	○
無電解Pdめっき	○	○
無電解Auめっき	○	○
工程数	6工程	7工程

選択析出性



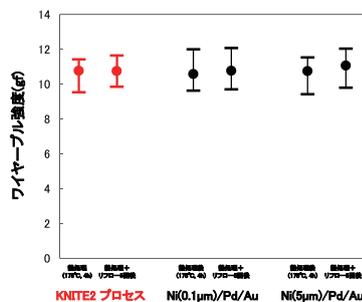
めっき皮膜断面



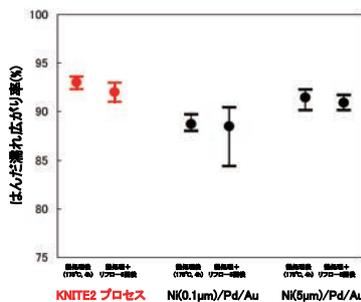
各種実装特性

※めっき膜厚仕様: Ni/Pd 0.1μm/Au 0.1μm

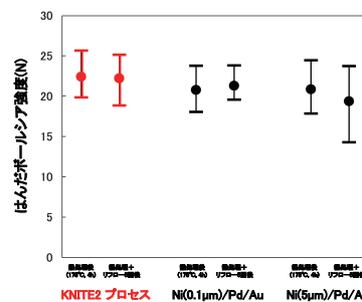
Auワイヤーボンディング特性



はんだ漏れ広がり特性

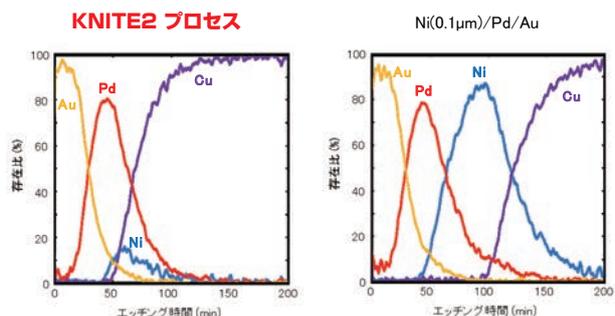


はんだ接合特性



耐熱性評価

※熱処理: 175°C、4h加熱後に、はんだリフロー(250°C)を5回実施



めっき皮膜結晶状態

